



平成 27 年 12 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証マザーズ
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電 話 03-5709-7685

連結子会社における固定資産の取得及び資金の借入に関するお知らせ

当社連結子会社である艾爾斯半導體股份有限公司が平成 27 年 11 月 13 日の取締役会において、下記のとおり固定資産を取得することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 27 年 11 月 13 日開催の当社取締役会において、艾爾斯半導體股份有限公司による本件固定資産の取得資金の借入を行うことを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取得の理由 シリコンウェーハ製造設備の拡充のため

2. 連結子会社の概要（平成 27 年 12 月 17 日現在）

名称	艾爾斯半導體股份有限公司
所在地	74144 臺南市臺南科學園區南科七路一號
代表者の役職・氏名	董事長 方 永義
事業内容	ウェーハ事業
資本金	200 百万新台幣ドル

3. 取得資産の内容

(1) 資産の名称	シリコンウェーハ表面検査装置 (MODEL, SP3)
(2) 取得予定価額	4,210,000 US ドル (515,767 千円) () 内の金額については、平成 27 年 12 月 17 日時点のレートに基づいて換算しております。

4. 相手先の概要

(1) 名称	KLA-Tencor Corporation
(2) 所在地	One Technology Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A
(3) 代表者の役職・氏名	Rick Wallace(CEO and President)
(4) 事業内容	半導体検査・計測装置の製造・販売
(5) 資本金	7億6594万米ドル(2002年6月期)
(6) 設立年月日	1997年5月1日
(7) 当社と当該会社の関係	当社及び当該会社との間には、記載すべき資本・人的関係はありません。また、当該会社は、当社及び子会社との関連当事者には該当いたしません。 取引は機械装置の保守契約などあり、金額は僅少です。

5. 取引の日程

(1) 子会社取締役会決議日	平成27年11月13日
(2) 引渡日	平成27年12月中
(3) 代金決済日	平成28年1月(予定)

6. 当社における資金の借入の理由

本件固定資産の取得を目的とする当該子会社への貸付を行うため、当社において資金を調達するための借入を行います。

7. 借入の概要

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
(2) 借入金額	500百万円
(3) 借入実行予定日	平成27年12月25日
(4) 借入期間	5年間
(5) 担保の有無	無担保

8. 今後の見通し

本件固定資産の取得及び本件借入による平成27年12月期の連結業績に与える影響は軽微と見込んでおります。今後、当社の財務及び業績等に影響を与える場合には、速やかに公表いたします。

以上